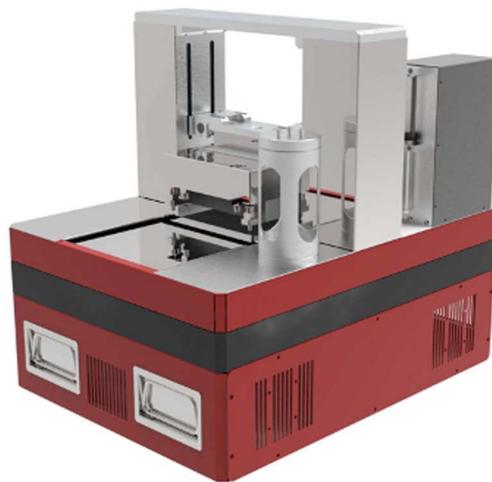


研发型狭缝涂布仪

CS-18

CS-18系统是面向研发和预生产客户提供的桌面式狭缝涂布解决方案。作为一种预先计量的涂布方法，狭缝涂布在材料使用方面非常高效，与其他沉积方法(如旋转涂布、喷涂或丝网印刷)相比，油墨的损耗水平非常低。通过预剂量计算，精确控制涂布头相对于基底的移动速度，及系统的供液速度，实现良好涂布。



Innovative Features:

- **供液速度精准可控:** 注液泵精准控制液体流速，提供0.5-500ul/s范围选择
- **材料黏度范围广:** 支持各类材料的涂布，可适配材料黏度范围广
- **膜厚控制精准:** 支持厚度从纳米到微米级别各类薄膜制备
- **涂膜均匀性高:** 高精度系统控制，薄膜均匀度可达95%以上
- **材料利用率高:** 材料利用率可达95%以上，减少材料浪费，降低使用成本
- **大范围平台移动速度:** 操作平台可稳定均匀移动，速度从0.1-500 mm/s可调
- **内嵌式软件控制:** 同步控制注液泵和平台移动，可保存多种不同涂布程序，简单易操作
- **原位真空加热台:** 可用于吸附柔性基底，精确控温对薄膜进行原位固化



研发型狭缝涂布仪

CS-18

规格参数

狭缝头材质	高强度专用合金+特殊表面热处理
涂布头宽度	150 mm (其他尺寸可定制)
涂布面积	150×150 mm (其他尺寸可定制)
工作平台	大理石真空吸附平台 (可定制不锈钢加热平台)
材料黏度	1 - 20,000 cps
最小涂布干膜厚度	0.1 μ m
干膜均匀度	>95%
平台移动速度	0.1 - 500 mm/s

产品展示



燃料电池涂布



钙钛矿电池涂布



透明导电薄膜涂布

